

电子

周跟踪 (20240520-20240526)

领先大市-A(维持)

三大原厂提高先进制程投片, HBM 需求持续看增

2024年5月27日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】OpenAI 发布新一代模型 GPT-4o, Q1 全球半导体制造业改善-山西证券电子行业周跟踪 2024.5.20

【山证电子】苹果发布 M4 芯片, 24Q1 全球半导体销售额同比+15.2%-山西证券电子行业周跟踪 2024.5.15

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码: S0760522050001

邮箱: xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周 (2024.05.20-05.24) 市场多数下跌, 上证指数跌 2.07%, 深圳成指跌 2.93%, 创业板指数跌 2.49%, 科创 50 跌 3.61%, 申万电子指数跌 3.49%, Wind 半导体指数跌 3.27%, 费城半导体指数涨 4.77%, 台湾半导体指数涨 3.52%。细分板块中, 周涨跌幅前三为半导体设备 (-2.22%)、消费电子 (-2.32%)、元件 (-2.45%)。从个股看, 涨幅前五为: 英力股份 (+80.20%)、隆扬电子 (+57.24%)、雷曼光电 (+35.17%)、鸿富瀚 (+31.29%)、康鹏科技 (+27.81%); 跌幅前五为: 石英股份 (-41.69%)、斯达半导 (-34.10%)、德福科技 (-31.40%)、骏成科技 (-31.24%)、信濠光电 (-31.05%)。

➢ **行业新闻:** 2024 年底 HBM 投片量预估占三大原厂先进制程比重 35%。据集邦咨询研究, 继存储合约价格翻扬后, 三大原厂开始提高先进制程投片, 产能提升将集中在今年下半年, 预期 1alpha nm (含) 以上投片至年底将占 DRAM 总投片比重约 40%。以各家 TSV 产能来看, 至年底 HBM 将占先进制程比重 35%, 其余则用以生产 LPDDR5(X)与 DDR5 产品。中国半导体产能将在未来五年增长 40%。TechInsights 预测称, 到 2029 年, 达到 875 百万平方英寸, 近三年设备采购的爆炸式增长正转化为产能的快速提升, 主要是 12 英寸晶圆厂的快速增长。台积电计划将特殊制程产能扩大 50%。台积电透露, 计划到 2027 年将其特殊制程产能扩大 50%。推动这一需求的主要因素之一是台积电的 4nm 级的超低功耗生产节点 N4e。目前, 台积电最先进的 N4e 同类工艺是 N6e, 工作电压在 0.4V 至 0.9V 之间, 预计未来 N4e 可能会降至 0.4V 以下。

➢ **重要公告:** 【腾景科技】拟向特定对象发行股票, 募资总额不超过人民币 48,500 万元, 用于光电子关键与核心元器件建设、泰国生产基地建设、研发中心建设项目。【中京电子】拟以简易程序向特定对象发行股票, 募资总额不超过人民币 30,000 万元, 用于新能源动力与储能电池 FPC 项目。【瑞玛精密】拟向特定对象发行股票, 募资总额不超过人民币 68,000 万元, 用于汽车空气悬架系统及部件生产建设、座椅系统集成部件生产建设项目。

投资建议

➢ 2024Q1 全球半导体制造业显示出改善迹象, 中国产能快速增长, 但当前需求复苏并不均衡。上半年由于生成式 AI 需求激增, 存储和逻辑景气度反弹; 汽车和工业市场景气度较弱, 模拟、分立器件小幅下降。随着 AI 边缘侧应用落地, 预计下半年将推动消费市场全面复苏; 随着库存下降, 汽车和工业市场有望恢复增长。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代, AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求, 及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。



## 目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

## 图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅半导体设备、消费电子、元件表现领先.....	4
图 3： 月涨跌幅元件、消费电子、其他电子表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅元件、消费电子、半导体设备表现领先.....	5
图 5： 半数板块当前 P/E 在历史平均值附近.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	6

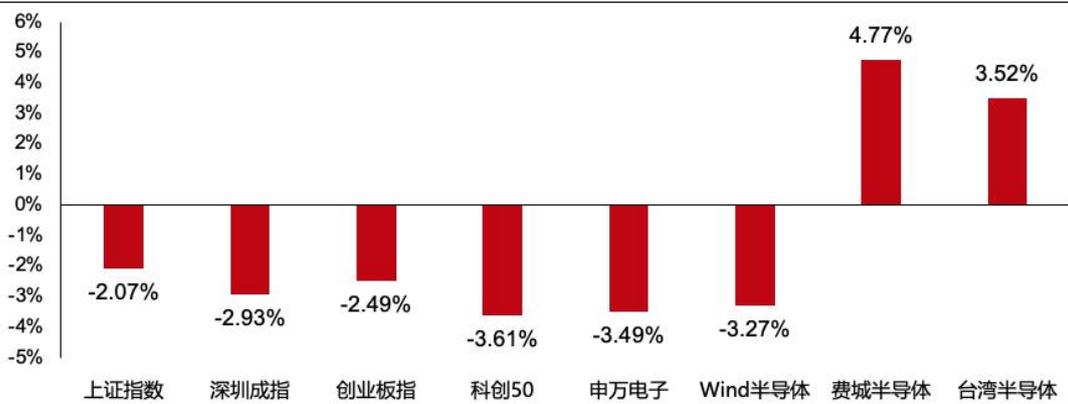
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%) .....	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片) .....	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

## 1. 行情回顾

### 1.1 市场整体行情

本周（2024.05.20-05.24）市场多数下跌，上证指数跌 2.07%，深圳成指跌 2.93%，创业板指数跌 2.49%，科创 50 跌 3.61%，申万电子指数跌 3.49%，Wind 半导体指数跌 3.27%，费城半导体指数涨 4.77%，台湾半导体指数涨 3.52%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

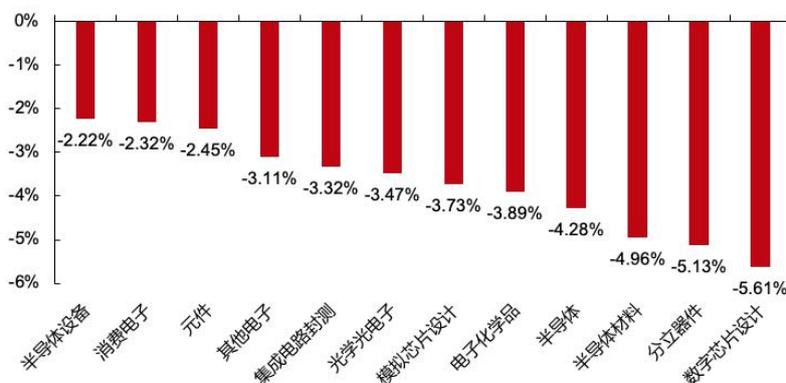


资料来源：Wind，山西证券研究所

### 1.2 细分板块行情

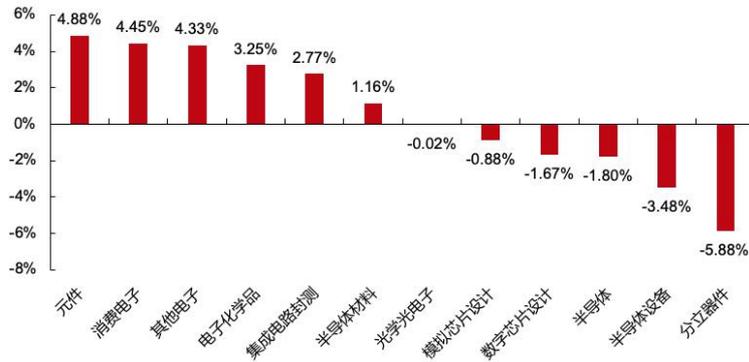
#### 1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅半导体设备、消费电子、元件表现领先



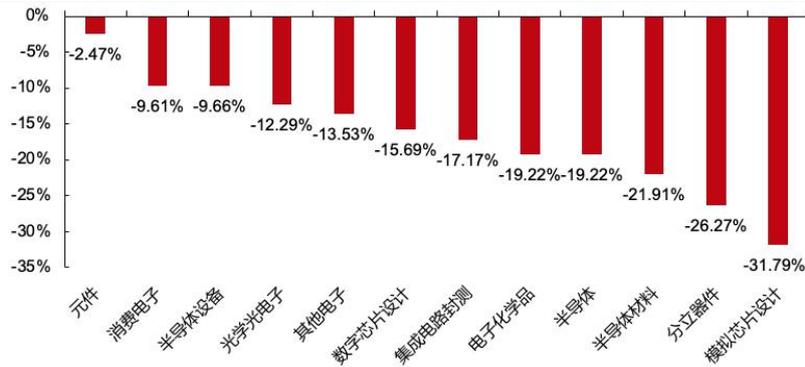
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅元件、消费电子、其他电子表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

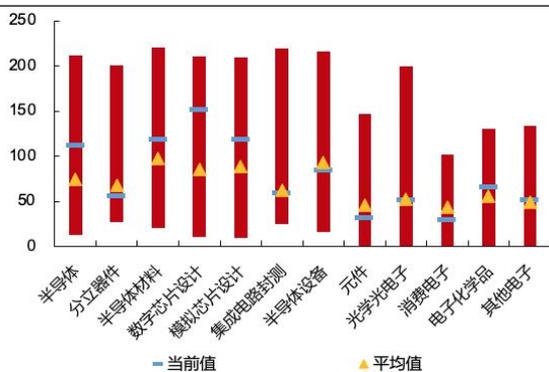
图 4：年初至今涨跌幅元件、消费电子、半导体设备表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

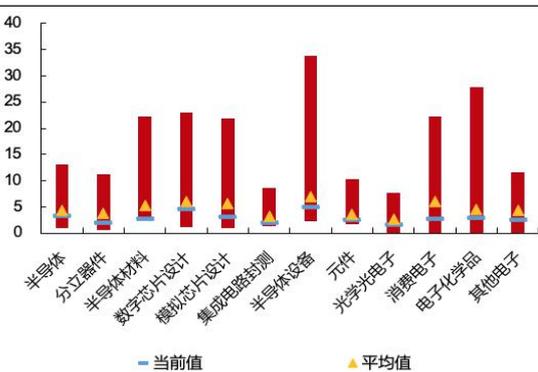
## 1.2.2 估值

图 5：半数板块当前 P/E 在历史平均值附近



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

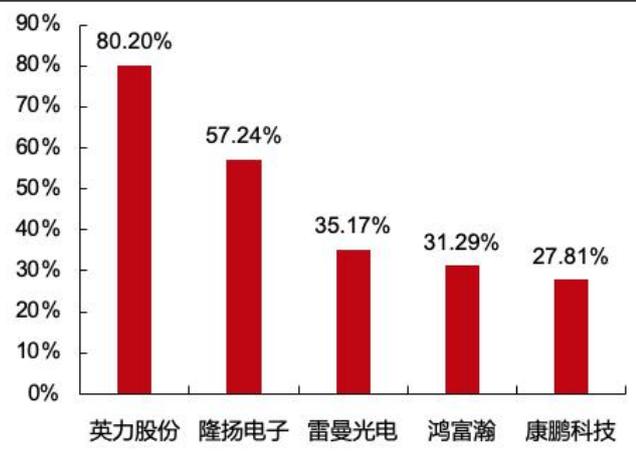


资料来源：Wind，山西证券研究所

### 1.3 个股公司行情

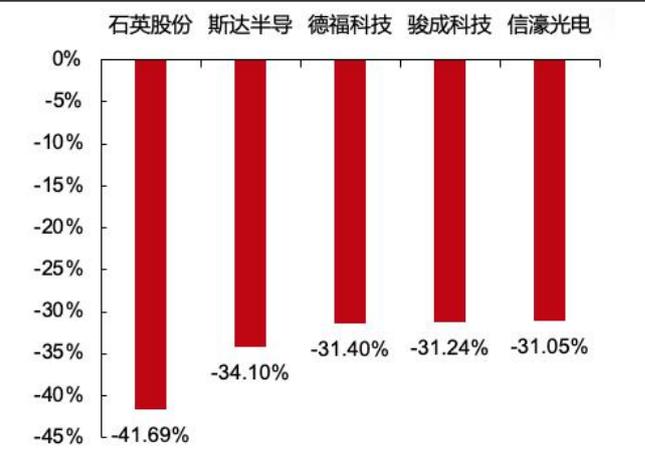
从个股情况看，英力股份、隆扬电子、雷曼光电、鸿富瀚、康鹏科技涨幅领先，涨幅分别为80.20%、57.24%、35.17%、31.29%、27.81%；石英股份、斯达半导、德福科技、骏成科技、信濠光电跌幅居前，跌幅分别为-41.69%、-34.10%、-31.40%、-31.24%、-31.05%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

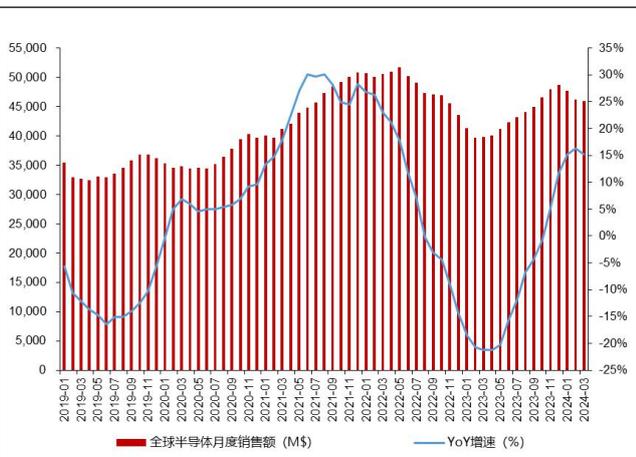
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

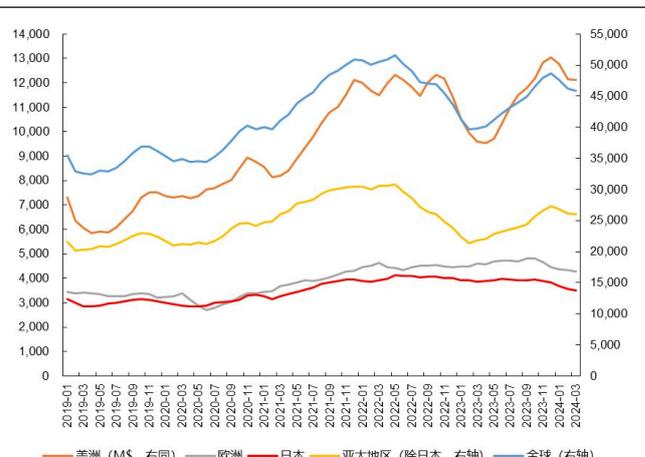
## 2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



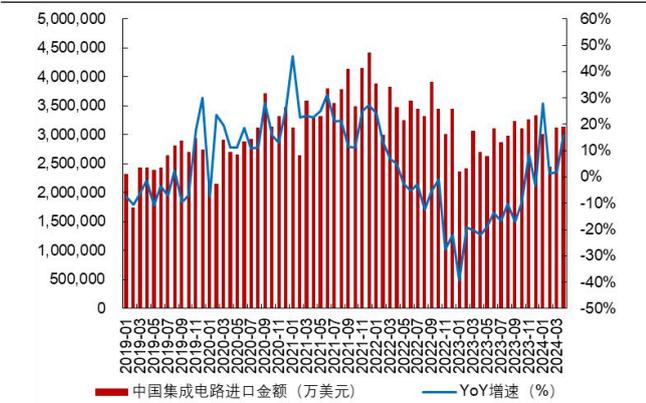
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



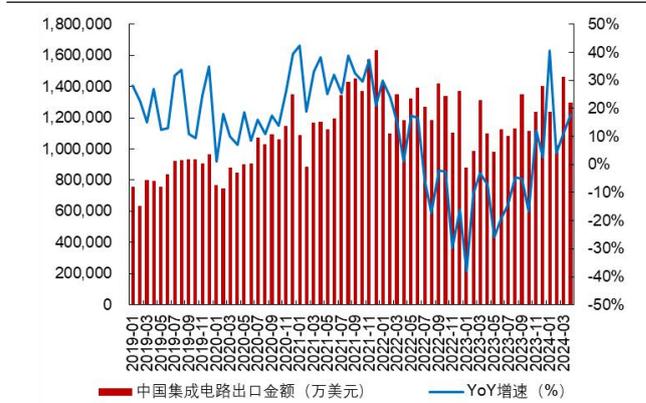
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11: 中国集成电路行业进口情况



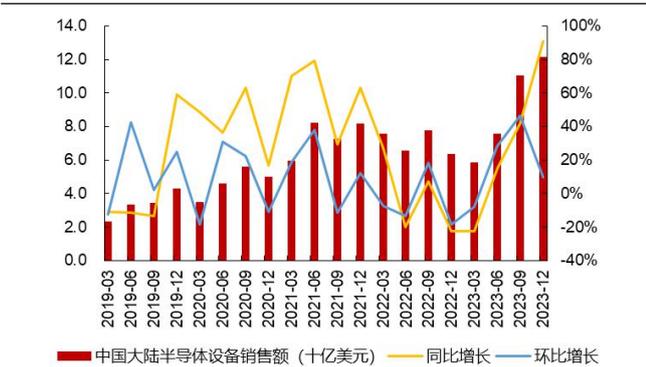
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 12: 中国集成电路行业出口情况



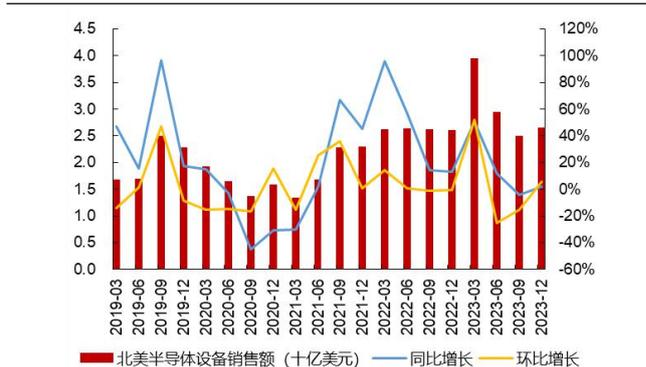
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 13: 中国大陆半导体设备销售额



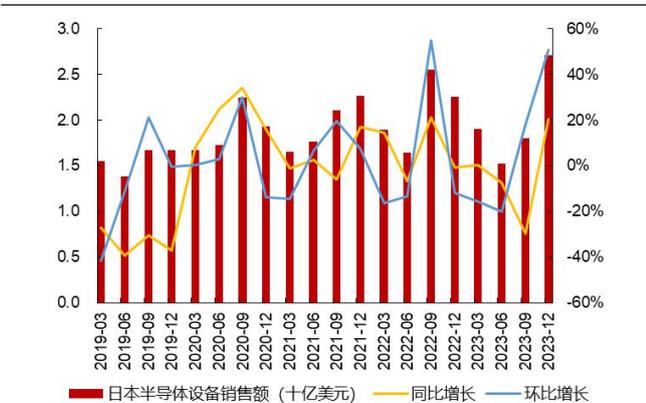
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 14: 北美半导体设备销售额



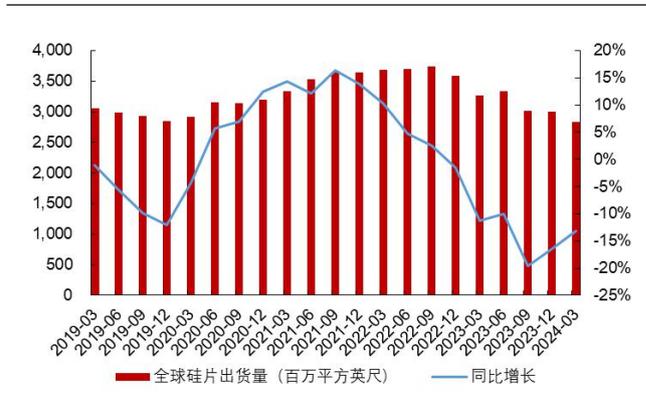
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 15: 日本半导体设备销售额



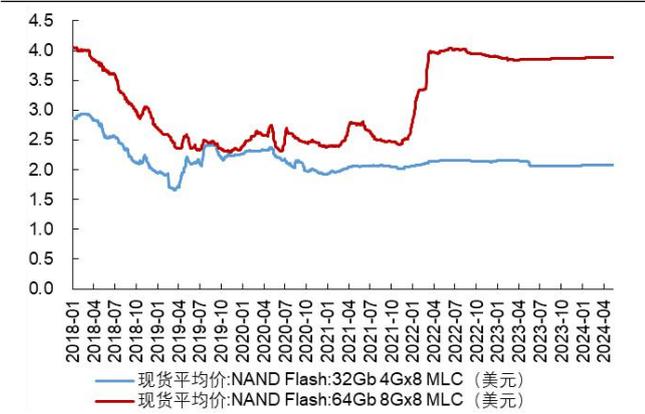
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 16: 全球硅片出货面积



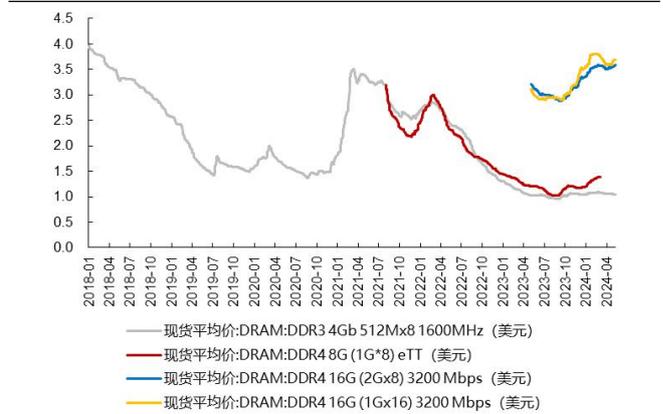
资料来源: SEMI, 山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



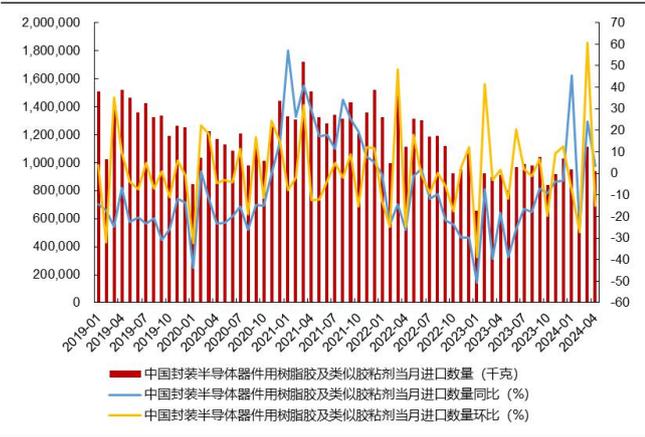
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



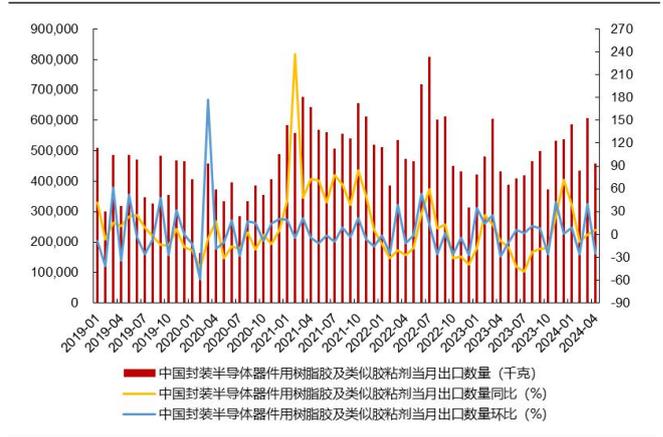
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



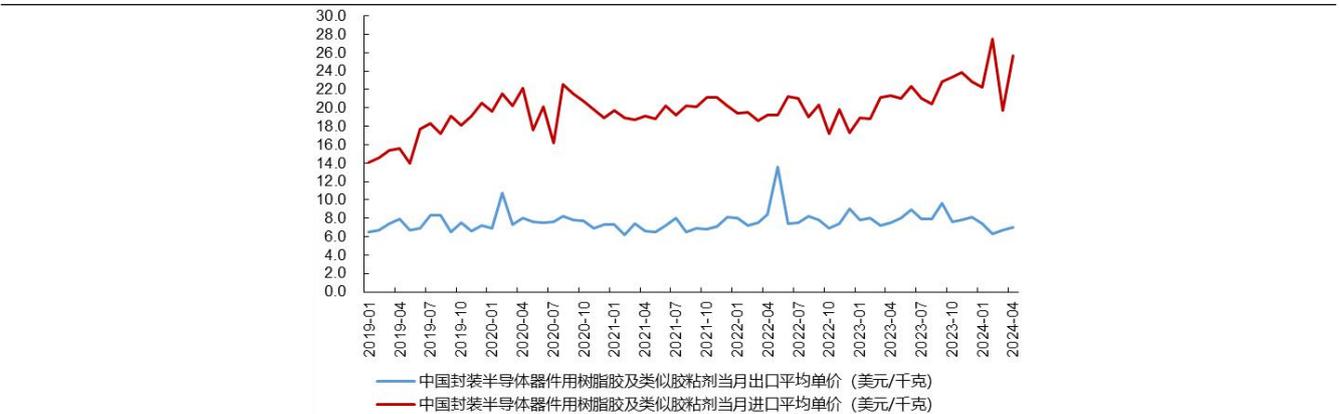
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



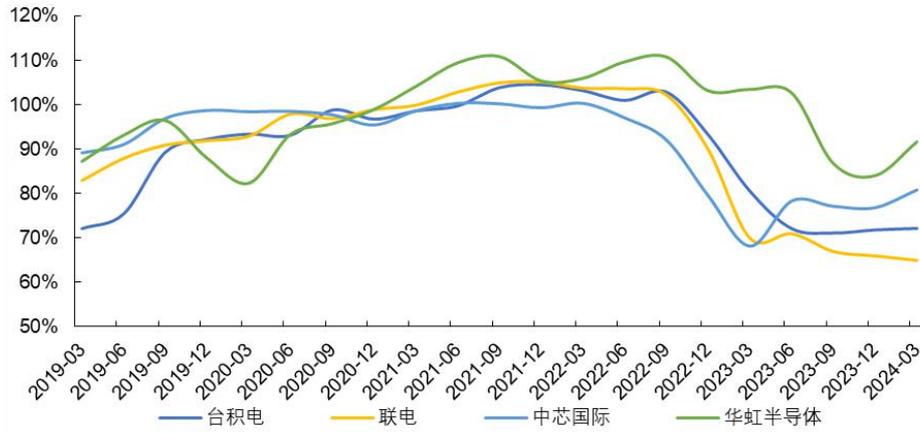
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



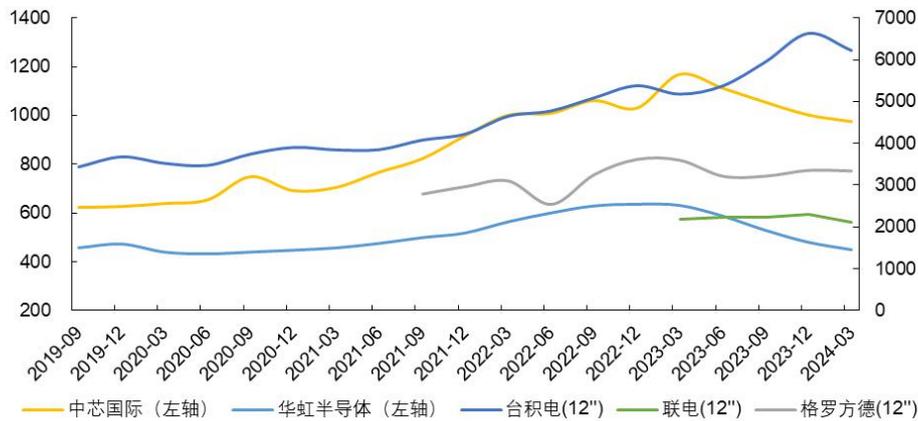
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

### 3. 新闻公告

#### 3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 5 月 20 日					
2024 年 5 月 21 日		瑜欣电子			瑞玛精密
2024 年 5 月 22 日	东南电子		中石科技、秋田微		

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年5月23日	ST瑞德		朗鸿科技、睿能科技、气派科技、隆扬电子		
2024年5月24日		希荻微、睿能科技	狄耐克、三德科技、世华科技、海洋王		中京电子
2024年5月25日		华特气体	芯瑞达、激智科技、达瑞电子		腾景科技

资料来源：Wind，山西证券研究所

## 3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年5月20日	<b>HBM3e 产出放量带动，2024 年底 HBM 投片量预估占先进制程比重 35%。</b> 据 TrendForce 集邦咨询研究，三大原厂开始提高先进制程的投片，继存储器合约价翻扬后，公司资金投入开始增加，产能提升将集中在今年下半年，预期 1alpha nm（含）以上投片至年底将占 DRAM 总投片比重约 40%。其中，HBM 由于获利表现佳，加上需求持续看增，故生产顺序最优先。但受限于良率仅约 50~60%，且晶圆面积相较 DRAM 产品，放大逾 60%，意即所占投片比重高。以各家 TSV 产能来看，至年底 HBM 将占先进制程比重 35%，其余则用以生产 LPDDR5(X)与 DDR5 产品。	集邦咨询
2024年5月21日	<b>谷歌承诺向芬兰数据中心投资 10 亿欧元。</b> 北京时间 5 月 21 日下午谷歌概述了投资 10 亿欧元扩建其芬兰数据中心园区的计划，试图利用该国的可再生能源，并实现其更广泛的可持续发展目标。	C114 通信网
2024年5月24日	<b>中国半导体产能将在未来五年增长 40%。</b> TechInsights 预测称，到 2029 年，中国半导体产能将增长 40%，达到 875msi（百万平方英寸）。中国的晶圆制造设备支出从 2018 年的 110 亿美元增长到 2023 年的近 300 亿美元。过去三年设备采购的爆炸式增长正转化为产能的快速提升。快速增长的主要是 12 英寸晶圆厂，尽管 8 英寸和 6 英寸晶圆厂也有一些增长。	TechInsights
2024年5月24日	<b>台积电：计划将特殊制程产能扩大 50%，</b> 获将增添 N4e 节点。台积电（TSMC）在五月中旬举行的欧洲技术研讨会上透露，计划到 2027 年将其特殊制程的产能扩大 50%，以提升半导体供应链弹性。该计划不仅需要转换现有产能以满足特殊工艺的需求，甚至有可能为此建立新的晶圆厂。而推动这一需求的主要因素之一，将是台积电的下一个特殊节点：N4e，一个 4nm 级的超低功耗生产节点。据悉，除了著名的 N5 和 N3E 等主要逻辑节点外，台积电还为功率半导体、混合模拟 I/O 和超低功耗应用（如物联网）等应用提供了一系列的特殊制程工艺节点。目前，台积电最先进的 N4e 同类工艺是 N6e，工作电压在 0.4V 至 0.9V 之间，预计未来 N4e 可能会降至 0.4V 以下。	SEMI
2024年5月24日	<b>台积电证实，南京厂获无限期豁免。</b> 5 月 24 日消息，经台积电证实，美国商务部近日已向台积电南京厂授予了“经认证终端用户”（Validated End-User, VEU），确认美国出口管制法规涉及的物品和服务得以长期持续提供给台积电南京厂，无需取得个别许可证，获得无限期豁免。据悉，目前台积电南京厂主要生产 16nm、28nm 成熟制程，为满足客户需求，将持续进行扩充南京厂 28nm 制程产能。此项正式的 VEU 授权将取代先前商务部自 2022 年 10 月以来核发的临时书面授权，并未增加新权限，因此台积电表示南京厂将维持生产现状。	SEMI

资料来源：集邦咨询，C114 通信网，TechInsights，SEMI，山西证券研究所

#### 4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

### 分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

### 投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

### 评级体系：

#### ——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

#### ——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

#### ——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

### 免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

### 山西证券研究所：

#### 上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

#### 太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层  
电话：0351-8686981  
<http://www.i618.com.cn>

#### 深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

#### 北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

